

ディスペンス用ソルダペースト

Solder paste for dispensing

印刷困難な立体形状や 2 次実装に対応

Supports three-dimensional shapes and secondary mounting that are difficult to print

ジェットディスペンサータイプ : $\phi 200\mu\text{m}$ 以下の吐出を実現

Jet dispenser type: realization of dispensing less than $\phi 200\mu\text{m}$.

エアディスペンサータイプ : $\phi 100\mu\text{m}$ の塗布及びレーザーによる加熱方式にも対応

Air dispensing type : capable of $\phi 100\mu\text{m}$ dispensing or applicable for laser soldering.

ジェットディスペンサー Solder paste for jet dispensing

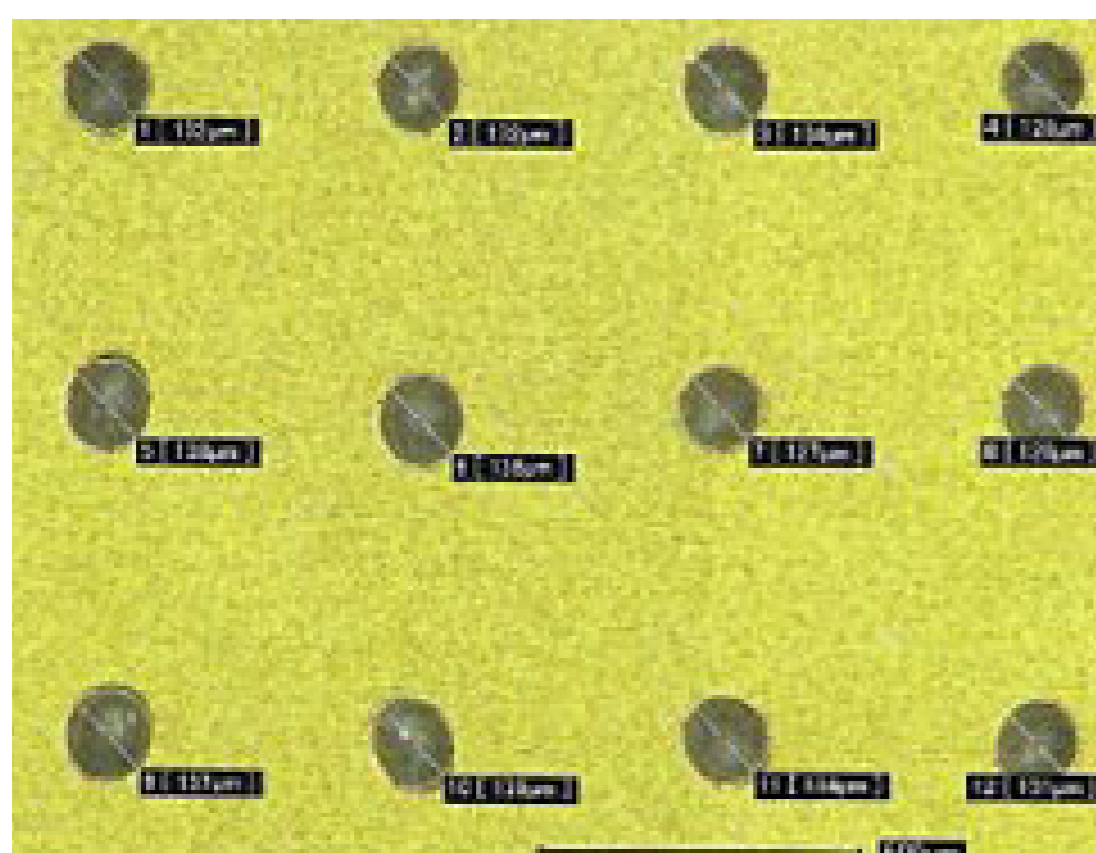
winDot-F005-NP303

ジェットディスペンサ塗布結果

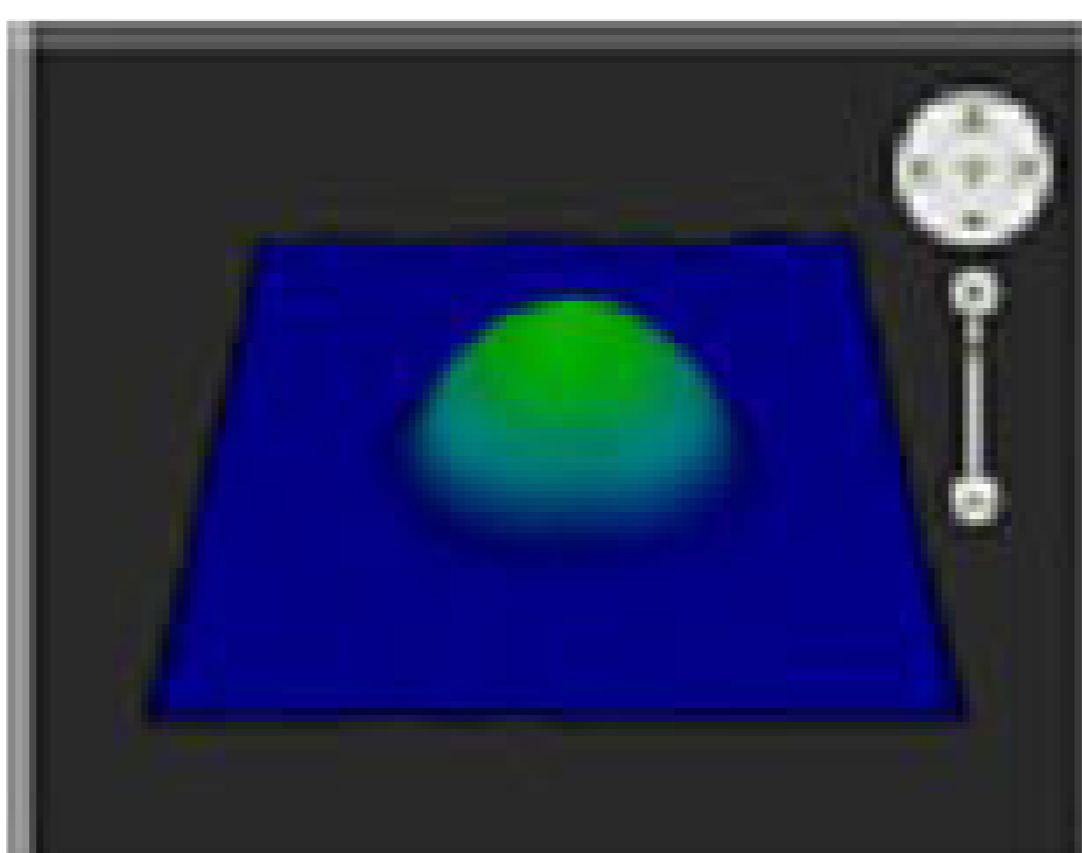
Jet Dispensing Result

塗布形状

Dispensing shape

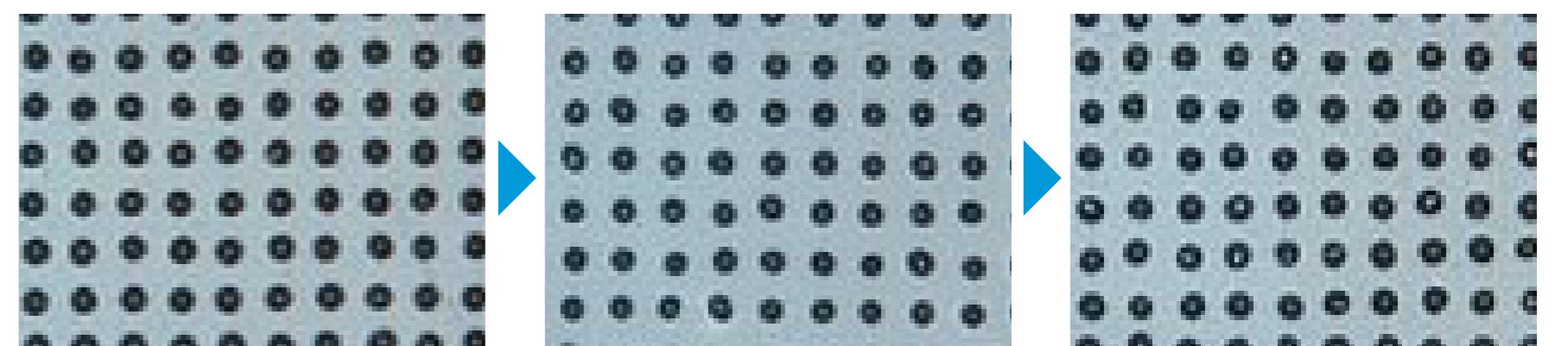


$\phi 200\mu\text{m}$ 以下で塗布可能
Can be applied at $\phi 200\mu\text{m}$ or less

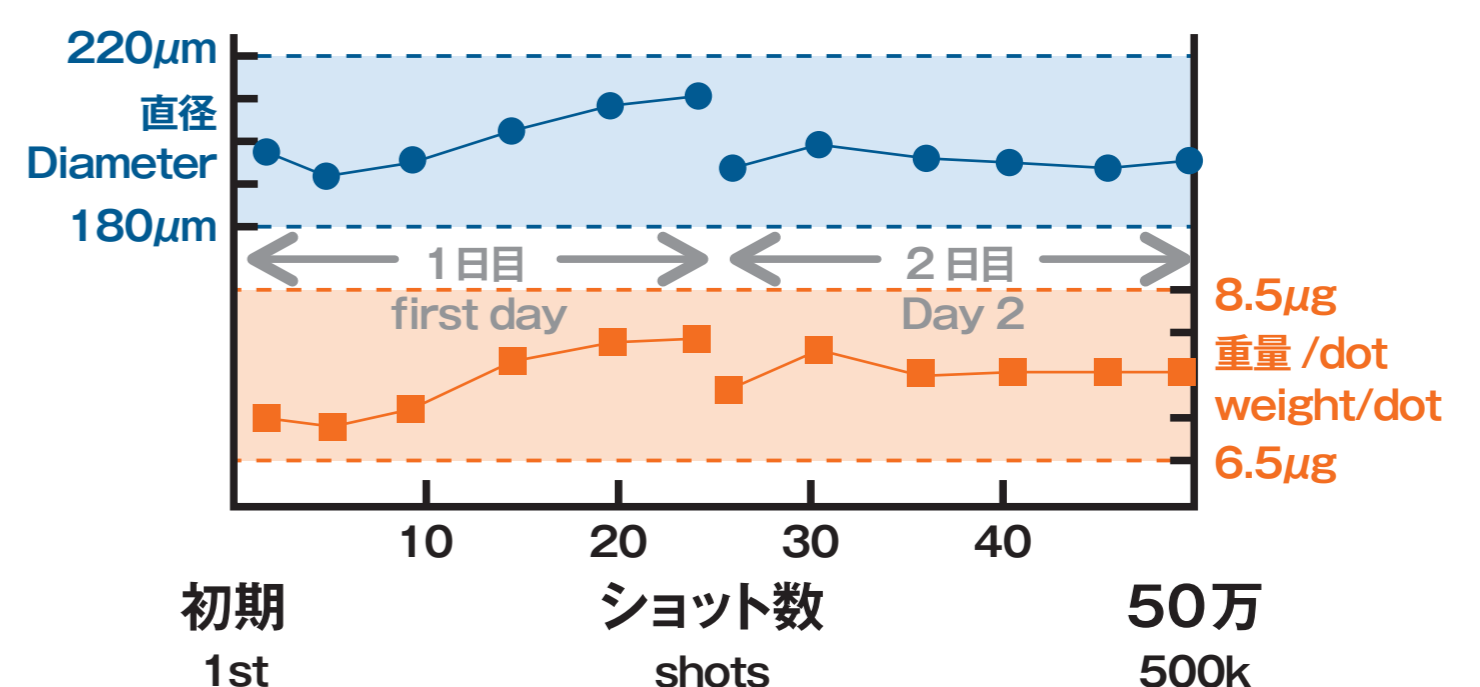


連続塗布性能

Continuous dispense result



初期 1st Shot 30万ショット 300k shots 50万ショット 500k shots



エアディスペンサー Solder paste for air dispensing

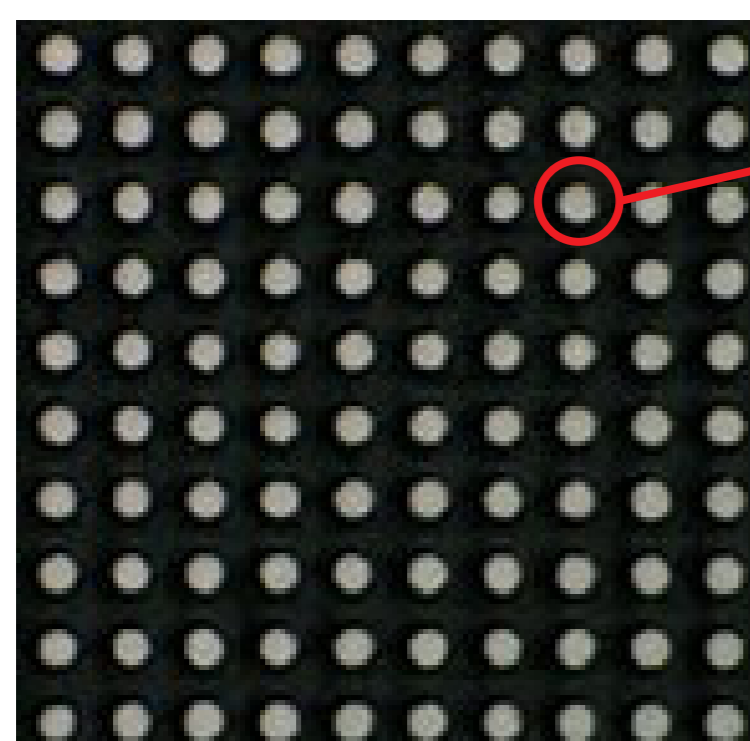
微小塗布対応品

Products for micro-diameter application

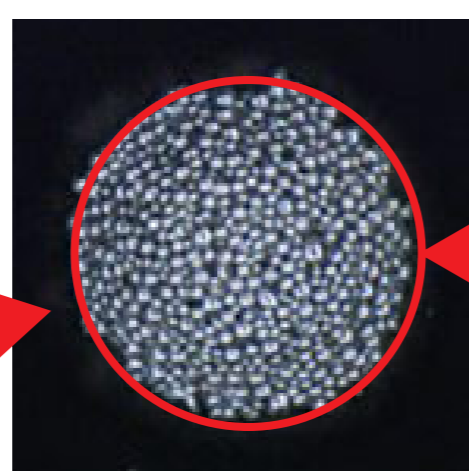
NP303-DPF201-T7

塗布形状

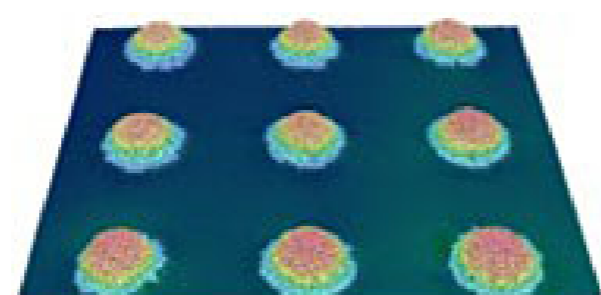
Dispensing shape



$\phi 100\mu\text{m}$ の安定塗布
Stable application of $\phi 100\mu\text{m}$



拡大
Enlarge



3D 形状
3D Shape

レーザー加熱対応品

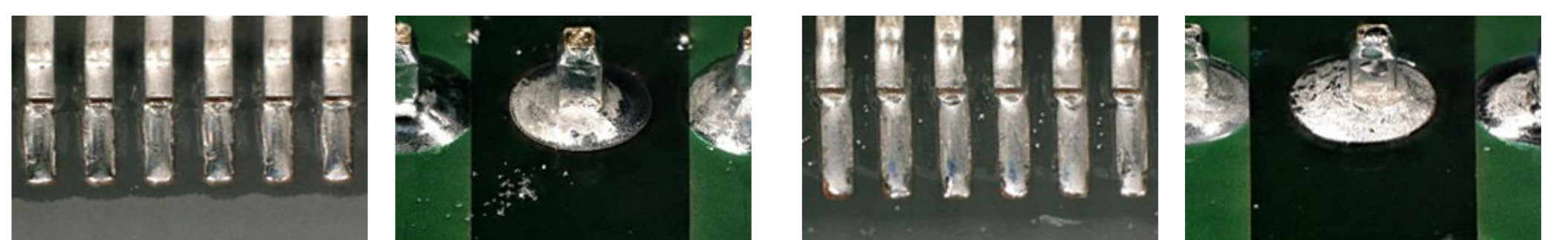
Products for laser soldering application

NP303-DPS101-T4

レーザーはんだ付け例

Laser soldering example

従来品 Conventional products NP303-DPS101-T4



レーザーによる急加熱に対応。
ぬれが速く、ボールが非常に少ない。
低融点 SB58 組成も対応。

Compatible with rapid heating by laser.
Fast wetting and very few balls.
Compatible with low melting point SB58 composition.

